

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2021-037

杭州长川科技股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长川科技”)于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对杭州长川科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第 205 号,以下简称关注函)。公司对关注函所提出的问题进行了认真核查和确认,现将有关问题及回复公告如下:

一、你公司《2020 年年度报告》显示,2020 年你公司实现营业收入 80,382.93 万元,同比增长 101.54%,实现归属于上市公司股东的净利润 8,485.94 万元,同比增长 610.99%。你公司 2020 年度拟现金分红 3,137.91 万元,占 2020 年度净利润的 36.98%。请你公司结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略、长短期投融资及生产经营计划、研发投入、营运资金安排及现金流状况等方面,详细补充说明制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性,与公司业绩成长性是否匹配,是否存在炒作股价的情形,并提示相关风险。

回复:

(一)结合所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略、长短期投融资及生产经营计划、研发投入、营运资金安排及现金流状况等方面,说明制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性,与公司业绩成长性是否匹配

1. 公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略

(1) 行业特点

1) 国家对集成电路制造高度重视

集成电路产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,作为现代信息产业的基础

和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。为支持推动集成电路产业发展，我国政府先后颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《集成电路产业“十二五”发展规划》、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策，同时各地政府也纷纷出台支持集成电路产业发展的地方政策。2014年，财政部和工信部共同推动设立了国家集成电路产业投资基金，首期募资规模达1,387.20亿元，投资并带动了集成电路设计、制造、封装测试等产业链上主要企业的发展，二期注册资本为2,045.10亿元，将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。在国家集成电路产业投资基金的带领下，北京、上海、武汉、厦门、合肥等产业聚集区也纷纷设立了地方政府投资基金，重点支持集成电路制造业，同时兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等上下游环节，实施市场化运作、专业化管理。在国家政策的大力支持下，我国集成电路产业正逐步实现产业升级和结构转型，发展速度明显快于全球水平，整体呈现蓬勃发展态势。集成电路产业的蓬勃发展将为我国集成电路企业以及为之配套的装备企业带来巨大市场机遇。

2) 全球集成电路重心向我国转移带来产业扩张和升级机遇

随着半导体制造技术和成本的变化，半导体产业正在经历第三次产能转移，行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。根据CSIA数据，2019年国内集成电路市场规模为7,562.3亿元，同比增长15.77%，2011年至2019年国内集成电路市场复合增长率达到23.20%，高于全球市场同期年复合增长率，中国已经超过美国、欧洲和日本，成为全球最大的集成电路市场。持续的产能转移不仅带动了国内集成电路整体产业规模和技术水平的提高，为集成电路装备制造业提供了巨大的市场空间，也促进了我国集成电路产业专业人才的培养及配套行业的发展，集成电路产业环境的良性发展为我国装备制造产业的扩张和升级提供了机遇。

3) 产品更新换代加速，新型应用领域不断涌现

集成电路行业虽然呈现周期性波动的特性，但整体增长趋势并未发生变化，每次技术变革持续带动行业增长。随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化的方向发展，新的智能终端产品层出不穷，使得集成电路产业的市场前景越来越广阔。以物联网为代表的新需求所

带动的如云计算、人工智能、大数据等新应用的兴起，逐渐成为集成电路行业新一代技术变革动力。集成电路下游应用领域的不断延展带动了市场需求的持续旺盛，集成电路行业的景气度有望保持上升趋势，有利于集成电路及其专业设备企业的发展壮大。

4) 集成电路设备进口替代趋势愈趋明显

半导体装备业具有较高的技术需求、人才需求、资金需求，由于我国半导体设备产业整体起步较晚，目前国产规模仍然较小，进口依赖问题较为严重，2019 年我国泛半导体设备国产率约 16%，集成电路设备国产化率约 5%，国产化率极低。虽然当前我国集成电路专用设备市场仍主要由国外知名企业所占据，但随着我国集成电路产业的不断发展，装备制造业技术水平的不断提高，集成电路的国产化势必向着装备国产化方向传导，国产设备进口替代趋势将愈趋明显，国产替代空间巨大。

(2) 公司发展阶段

公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。公司秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业文化精神，在将现有产品领域做专、做强，保持产品市场领先地位的基础上，重点开拓探针台、数字测试机、三温分选机、AOI 光学检测设备等相关封测设备，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场。在成功研制数字测试机和探针台后，公司产品覆盖了测试机、探针台和分选机三大块主要测试设备。

公司目前处于快速发展阶段，持续扩大业务规模，完善公司产品布局是公司发展的核心要务。公司作为集成电路测试设备提供商，深耕测试设备行业多年，掌握了测试机、分选机、探针台等半导体测试设备的关键技术，凭借优异的产品质量及售后服务实现了部分半导体测试设备的进口替代，产品获得长电科技、华天科技、士兰微、华润微、日月光等多个一流集成电路厂商的使用和认可。未来公司将在目前市场占有率的基础上进一步加强技术优势，完善产品布局，加大国内外销售网络的建设，进一步强化品牌效应，力争成为国际领先的集成电路测试设备企业。

(3) 公司业绩增长的可持续性

面对国产设备加速替代进口的市场机遇，公司在深入研究集成电路装备业发

展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，持续提升产品技术深度，不断开发新的产品线，公司 2019 年通过收购 STI 公司进入自动化半导体光学检测设备（AOI）领域，在进行外部收购兼并的同时，公司也积极自主研发探针台、数字测试机等产品。2017 年至 2020 年，公司营业收入从 17,979.45 万元上升至 80,382.93 万元，复合增长率达 64.74%，公司各项业务保持快速发展。

在行业快速发展、利好不断的背景下，公司持续引进海内外高端人才，坚持加大产品研发投入和技术创新力度，不断提高产品性能和市场竞争力，以稳定可靠的质量和强劲的性能满足不同客户的多样化测试需求，提升了产品的市场竞争力，公司在半导体测试设备行业的领先地位也进一步稳固。

综上所述，公司发展仍具有较大的成长空间，公司业绩增长的可持续性具有一定的现实基础，具备持续盈利的能力与水平。

（4）经营模式

1) 盈利模式：公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，通过向下游封装测试、晶圆制造、芯片设计行业公司销售测试设备实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于集成电路测试设备产品的销售，其他业务收入来源于设备相关配件销售及设备维护收入等。

2) 采购模式：为保证公司产品的质量和性能，公司生产管理部会同技术质量部、财务部共同对供应商进行遴选，主要考虑供应商的经营规模、产能规模、技术水平、产品质量、产品价格、交货期、售后服务等因素，并经样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录，并持续更新。目前，公司已与多家供应商建立了长期、稳定的合作关系。

3) 生产模式：公司在以销定产的基础上，实行订单式生产和库存式生产相结合的方式。订单式生产指根据已有的客户订单进行的生产，库存式生产指根据年度销售计划进行的预生产。公司销售部负责接收客户需求，若客户需求产品为公司现有的量产机型，销售部将向生产管理部下发生产计划，生产管理部负责组织生产活动；若客户需求产品为全新机型，则由销售部组织相关的技术协议评审和设计开发，经技术评审和设计开发后销售部向生产管理部下发生产计划。生产管理部收到生产计划后随即组织生产，向制造部下达生产指令并负责原材料的收发。制造部负责整机的装配和调试，调试完成后由质量部负责成品的入库检验，

由制造部进行成品入库。

4) 销售模式：公司采取直销的销售模式，主要通过商业谈判和招投标方式获取订单。公司按照华东、华南和西北等地区进行区域化营销管理，并在上海、南通、天水等地设置了营销服务点。公司营销秉承主动服务、定期回访的理念，销售部负责营销、市场推广、订单跟踪、客户回访、货款回收等销售管理工作，客户服务部负责产品的安装、调试和技术支持等工作。

5) 研发模式：公司研发部门负责产品的研发和技术创新，公司建立了以分选系统研发中心、测试系统研发中心、长川日本研发中心为核心，研发管理部、销售部、客户中心、技术质量部等多个部门紧密合作的研发体系，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的组织形式。公司的研发流程包括了设计输入、技术方案评估、项目立项、方案制定、评审和开发、测试验证和定型等阶段，根据来源和目的分为新产品研发、技术改进和技术预研三大类。

(5) 未来发展战略

公司在深入研究集成电路专用设备行业发展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式：

产品深度方向。发挥现有核心技术优势，不断探索产品技术深度，力求将产品做精、做专，不断提高产品的市场竞争力；

产品线宽度方向。通过市场调研、产品规划、现有技术延展、新技术的研究，不断开发新的产品线，为公司的发展开拓新的增长点；

市场开拓方向。不断提升公司研发水平、产品品质，加强公司品牌建设，从中低端市场向中高端市场、从国内市场向国外市场开拓，将公司打造成为国际集成电路装备业的知名品牌。

未来，公司将继续秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业文化精神，坚持“以市场需求为导向”，围绕自身技术优势，结合行业发展趋势，持续进行产品研发创新，提升企业管理水平，不断培养专业化人才，不断进行产品的改进和升级，满足境内外客户对高性能测试设备的需求，积极融入全球化的竞争格局，力争成为国际一流的集成电路装备供应商。

综上所述，公司所处行业特点、目前发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略等均具有资本密集型特点，均对公司股本规模有较高要求。目前公司的股本规模偏小，不利于公司的市场形象，也不利于提高公司的竞争力，因此公司存在扩大股本规模的实际需求。

(二) 长短期投融资及生产经营计划、研发投入、营运资金安排及现金流状况

1.长短期投融资计划

(1) 投资计划

截至目前，公司的主要投资计划为公司 2020 年向特定对象发行股票的募投项目“探针台研发及产业化项目”。上述投资项目均围绕公司主营业务开展，成功实施后，一方面，将打破国外企业在探针台设备领域的垄断，实现自主品牌进口替代，降低探针台设备进口依赖程度，满足我国集成电路产业发展需要，另一方面，将拓宽公司产品线，有利于增加公司盈利来源、优化公司收入结构，进一步提高公司市场竞争力，巩固公司行业地位。除此之外，公司不存在其他重大投资计划。

(2) 融资计划

综合考虑公司的发展战略、发展规划及未来支出情况，公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》，拟向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该议案尚需 2020 年度股东大会审议通过。除此之外，公司不存在其他重大融资计划。

2. 生产经营计划

(1) 产品技术升级计划

公司坚持以“以客户为中心，以市场为导向”为宗旨，建立高效的研发团队，保证研发部与公司各部门之间的协同合作，积极响应客户需求，进一步优化现有技术。

（2）技术研发储备计划

公司将时刻关注国内外最新动态和行业前沿技术，密切跟进集成电路测试设备行业的发展趋势，注重前瞻性技术开发储备，通过技术研发不断掌握集成电路测试设备的技术核心，促进公司产品结构的不断优化，满足多样化的市场需求。

（3）市场开拓计划

公司将坚持以直销为主的经营模式，采取“内资—合资—外资，东南亚市场—欧美市场”的分步式营销策略。未来将加大宣传力度，提高公司品牌知名度和市场占有率。

（4）人才培养计划

人才是公司赖以生存和发展的基础，是公司产品创新和技术升级的根本。为此，公司将从以下几个方面加强人才培养计划，加强人才团队建设。

1) 人员招聘

第一，公司采取“内培外引”紧密结合的方式，在内部培养的同时，积极引进外部优秀人才，提升团队战斗力；第二，建立关键人才的招聘渠道，配合海外市场发展，拓展海外人才招聘；第三，强化与国内知名院校合作，建设实习和体验基地，吸引更多优秀人才的加盟；第四，积极参加国际交流以及相关的行业协会，利用公司可提供的各种激励措施，挖掘和引进尖端技术人才，全面提升技术创新能力。

2) 企业文化建设

公司将继续推行“诚实守信、艰苦奋斗、团队合作、开放学习、以客户为中心”的核心价值观，促进员工之间的交流，培养员工的归属感，传递长川“家”文化，为员工提供良好的工作环境。

3) 人员培训

公司将结合自身特点，进一步优化员工的入职培训、专业技能培训、综合素质培训和相关的管理培训，加大在业务技术、晋级培训、项目技术交流等方面的人才培训和再教育，建立现代人力资源管理机制，形成轻松、和谐和创新的工作

氛围。对工作业绩突出的人员给予继续教育的机会，建立个体成长机制，使他们与企业共同成长。

4) 管理提升计划

管理是企业赖以生存的基础，是企业持续发展的基石。除建立科学的管理制度，公司还将进一步加强与客户、供应商、监管机构、媒体、第三方评价机构等之间的沟通合作，以提升企业形象和品牌知名度，提高市场竞争力。

3. 研发投入

2018年至2020年公司研发投入及研发人员变化情况如下：

项目	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	505	380	244
研发人员数量占比	54.65%	49.22%	53.98%
研发投入金额（万元）	19,211.61	10,697.84	6,170.99
研发投入占营业收入比例	23.90%	26.82%	28.55%

集成电路专用设备业属于技术密集型产业，公司的研发能力和研发投入是决定其能否保持或超越行业发展速度及实现扩张的重要因素。近年来，公司抓住了我国集成电路专用设备行业快速发展以及进口替代的有利时机，凭借较强的自主创新能力，获得了快速发展。为加快提升公司的市场份额和行业地位，以及满足集成电路日益增长的国产化需求，公司仍需持续加大研发投入和技术创新，不断提高产品性能和市场竞争力，以支持公司长期可持续发展。

4. 营运资金安排及现金流状况

公司2018年末、2019年末、2020年末，营运资金（流动资产-流动负债）分别为26,974.42万元、53,159.27万元、76,242.16万元；2018年至2020年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,244.94万元、-4,288.98万元、4,460.12万元。公司营运资金规模持续增长，现金流与公司业务发展情况相适应，公司根据近期实际经营情况及用款需求综合考虑，认为本次利润分配方案不会影响公司的正常经营。

（三）制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长性是否匹配

根据公司《2020 年度利润分配预案》，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 31,379.05 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利为人民币 3,137.91 万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东拟每 10 股转增 9 股，转增后公司总股本增加至 59,620.20 万股。公司拟定此次利润分配方案具有合理性，具体如下：

1. 业绩的持续稳定增长是公司制定利润分配方案的基础

公司近几年业绩持续保持良好的增长态势，2018 年至 2020 年公司营业收入从 21,612.15 万元增长至 80,382.93 万元，剔除股份支付费用、与收购相关的中介机构费用以及商誉减值损失等因素影响后，公司利润总额从 5,927.06 万元增长至 9,278.72 万元。公司具备稳健、可持续的盈利能力，本次分红方案具有合理的业绩基础。

2. 转增股本是公司实际需求

截至 2020 年末，公司资本公积金余额为 58,926.67 万元，股本为 31,379.05 万股，具备资本公积转增股本的条件。通过转增股本可以增加上市公司股票的流通数量，提升股票流动性，进而优化股本结构，且股本增加有利于公司的市场形象和竞争力的进一步提升，因此公司具有转增股本的现实需求。

3. 监管政策倡导下，投资者权益的积极维护

根据证监会、财政部、国资委和银监会四部委于 2015 年 8 月联合发布的《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》（以下简称“《通知》”），上市公司应建立健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，并在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在 2020 年取得良好经营业绩的基础上坚持现金分红，符合《通知》的相关精神，有利于回报投资者，增强投资者对公司以及未来收益的信心，建立长期的良性投资回报机制，促进公司的可持续性发展。

4. 本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的制定

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份（2021 年修订）》第二条的规定“高送转，是指主板、创业板上市公司每十股送红股与公积金转增股本合计分别达到或者超过五股、十股”。公司本次拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，不属于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份（2021 年修订）》所规定的高送转情形。

依据《公司章程》规定，“在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，或任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。”公司本次分红方案占当年实现可分配利润的 36.98%，符合《公司章程》的规定，具有合规性。

综上，本次利润分配综合考虑了所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、业绩增长的可持续性、未来发展战略、投融资及生产经营计划、研发投入、运营资金安排和现金流状况、总股本等情况，符合相关法律法规、《公司章程》以及监管部门有关上市公司分红文件的意见，与公司业绩成长性匹配，具有合理性及必要性。

（四）公司不存在通过分红及转股方案炒作股价的情形

综上，公司经营状况良好，营业收入快速增长，具备持续稳定的盈利能力，在 2020 年公司业绩大幅增长的情况下，综合考虑所处行业、公司发展阶段、业绩增长的可持续性、未来发展战略等诸多因素后，拟定了本次利润分配的方案。公司 2020 年度利润分配预案与公司经营发展状况相匹配，符合公司所处行业特点、公司发展阶段和研发投入等方面的需求，有利于提高公司的市场形象和竞争力，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司发展成果，符合全体股东的利益，具有合理性及必要性，公司不存在通过高比例分红及转股方案炒作股价的情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

(五) 风险提示

1. 公司本次利润分配方案存在不确定性的风险

本次利润分配方案中的资本公积金转增股本，对公司报告期内净资产收益率没有实质性影响；投资者同比例增加所持有股份，对其持股比例亦无实质性影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。另外，本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过方才生效，目前尚存在不确定性。

2. 行业波动风险

近年来，全球半导体设备市场持续周期性波动态势给公司带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，快速提升对相关设备的需求；在行业景气度下降过程中，半导体产业削减资本支出，进而对半导体设备的需求产生不利影响。公司的销售和盈利情况也会受到上述影响发生相应波动，带来相应的经营风险。

3. 成长性风险

2018年、2019年和2020年，公司营业收入分别为21,612.15万元、39,883.41万元、80,382.93万元，总体呈快速增长态势。虽然公司已在集成电路测试设备制造领域积累了较为丰富的经验，但如果公司未能及时招聘足够的专业人才，可能对公司的研发速度产生不利影响；同时，如果公司的市场拓展能力跟不上公司的扩张计划，可能导致公司的市场占有率下滑，将会对公司成长性带来不利影响。

二、请你公司补充说明本次利润分配预案筹划、制定及决策过程，以及你公司在信息保密方面所采取的措施，相关内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配预案披露前一个月内买卖公司股票情况，并核实是否存在信息泄漏和内幕交易情形。

回复：

（一）公司本次利润分配预案筹划、制定及决策过程

2021年4月18日，公司董事长与财务总监及董事会秘书结合公司经营情况、股本结构等因素，初步讨论了现金分红、资本公积转增股本等事项，形成了拟进行现金分红与资本公积转增股本相结合的分配方式，并于4月19日发出董事会及监事会会议通知。

2021年4月22日，公司董事长与财务总监及董事会秘书初步确定了现金分红、资本公积转增股本的比例。

2021年4月23日，公司将写有公司现金分红与资本公积转增股本方案的年度报告、董事会会议材料等发送至全体董监高人员。

2021年4月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年4月26日，公司在股票市场收市后向深圳证券交易所上传并披露了《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

（二）公司在信息保密方面所采取的措施

公司已制定《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》等内控制度，明确了内幕信息的传递、登记备案等要求，在此次利润分配及资本公积转增股本预案筹划过程中，公司已通过多种方式要求董监高及其他知情人严格遵守信息保密原则，不得存在内幕交易情形，并充分提示窗口期交易、内幕交易等风险。公司已于2021年4月27日向深交所报备了2020年年度报告编制、利润分配及资本公积转增股本预案的内幕信息知情人情况。

（三）相关内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配预案披露前一个月内买卖公司股票情况

经公司自查及向相关内幕信息知情人员询问核实，相关内幕信息知情人员及其近亲属在利润分配预案披露前一个月内无买卖公司股票情况。

三、你公司持股 5%以上股东杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）于 2021 年 3 月 19 日披露减持计划，拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过 193.81 万股；你公司持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日披露减持计划，拟于公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过 627.58 万股。请说明你公司是否存在配合大股东、董事、监事和高级管理人员进行减持的情形，自 2020 年度利润分配方案披露之日起六个月内大股东、董事、监事和高级管理人员是否存在其他减持计划，若是，请详细披露。

回复：

（一）公司不存在配合大股东、董事、监事和高级管理人员进行减持的情形

经公司自查，持股 5%以上股东杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）及国家集成电路产业投资基金股份有限公司自其减持计划公告披露日至 2021 年 4 月 30 日，均未对公司股票进行减持。公司严格按照新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关上市公司信息披露规范要求，并结合公司内部控制规范，严格执行《信息披露管理制度》并及时上报相关内部信息知情人数据，信息披露真实、准确、完整，不存在向特定投资者泄漏利润分配预案相关信息的情形。

公司本次利润分配方案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于建立长期的良性投资回报机制，增强公司股票的流动性和优化股本结构，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

综上，公司不存在配合大股东、董事、监事和高级管理人员减持股份的情形。

（二）自 2020 年度利润分配方案披露之日起六个月内大股东、董事、监事和高级管理人员目前不存在其他减持计划

经与公司持股 5%以上的股东、董监高人员确认，截止本回复披露日，除杭

州长川投资管理合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在减持计划外，自 2020 年度利润分配方案披露之日起六个月内，其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员目前不存在减持计划。

四、请说明 2020 年度利润分配方案披露前一个月内公司接受媒体采访、机构调研的情况，并核实是否存在向特定投资者泄露未公开重大信息等违反信息披露公平性原则的情形，以及是否存在配合炒作股价的情形等。

回复：

公司在披露《2020 年度利润分配预案的公告》前一个月内未接受投资者调研或媒体采访，不存在向特定对象泄露利润分配及资本公积转增股本预案及其他重大信息的情形，亦不存在配合炒作股价的情形。

五、你认为需要说明的其他情况。

回复：

公司不存在其他需要说明的事项。

特此回复。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 7 日